



Title of Change:	Mold Compound Change attributed to an End of Life of Samsung SDI EMC for products in TO-264 package.							
Proposed first ship date:	17 January 2020							
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Support@onsemi.com>							
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Support@onsemi.com> , <Bokyun.Seo@onsemi.com> ; <Khairil.FK@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.							
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Lake.Wang@onsemi.com>							
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>							
Change Part Identification:	Product with date code 1949 or newer will be assembled with the new mold compound.							
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____							
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____							
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Suzhou, China	External Foundry/Subcon Sites: NA						
Description and Purpose: ON Semiconductor wishes to inform our customers of a change in mold compounds used for the devices listed in this PCN. This change is a result of an End of Life notification received from Samsung for several of their SDI Mold Compounds. Due to the discontinuance of the SDI mold compounds, ON Semiconductor will only have limited supplies of the existing material and in some cases this may not allow for the normal change notification period. All other aspects of the impacted products (form, fit, function) will remain unchanged.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>SL-7300HFM; Supplier: Samsung SDI</td> <td>KTMC1050GFA, Supplier : KCC</td> </tr> </tbody> </table>			Before Change Description	After Change Description	Mold Compound	SL-7300HFM; Supplier: Samsung SDI	KTMC1050GFA, Supplier : KCC
	Before Change Description	After Change Description						
Mold Compound	SL-7300HFM; Supplier: Samsung SDI	KTMC1050GFA, Supplier : KCC						



Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: FJL6920TU (PTI : FD)RMS : U56663PACKAGE : TO-264

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +110°C, RH=85% , 264hr, bias = 80% of rated V or 100V max	264hr	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

QV DEVICE NAME: FGL40N120ANDTU (PTI : FC)RMS : U56660PACKAGE : TO-264

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	TA = 150 °C for 1008 hours, 100% rated Vgs	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +130°C, RH=85%, 96hr, bias = 80% of rated V or 100V max	96hr	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

QV DEVICE NAME: SGL160N60UFDTU (PTI : FC)RMS : U56661/U59581PACKAGE : TO-264

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	TA = 150 °C for 1008 hours, 100% rated Vgs	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +130°C, RH=85%, 96hr, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hrs	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

All reliability result passed

**Electrical Characteristic Summary:**

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
2SA1943RTU	FJL6920TU
FJL43150TU	
FGL12040WD	FGL40N120ANDTU
FGL35N120FTDTU	
FGL40N120ANTU	
FGL60N100BNTD	
FGL40N120ANDTU	
FGL60N100BNTDTU	
SGL160N60UFDTU	SGL160N60UFDTU
SGL50N60RUFDTU	
FDL100N50F	
FQL40N50	
FQL40N50F	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22647XK

発行日 : 10 October 2019

変更件名:	TO-264 パッケージ製品の Samsung SDI 製モールド コンパウンドの生産終了に伴うモールド コンパウンドの変更	
初回出荷予定日:	17 January 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com>, <Bokyun.Seo@onsemi.com>, <Khairil.FK@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <Lake.Wang@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	日付コード 1945 以降の製品は、新しいモールドコンパウンドで組み立てられます。	
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製造プロセスの変更 ☒ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Suzhou, China	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし
説明および目的: オン・セミコンダクターは、本 FPCN に列記された製品に使用するモールド コンパウンドの変更をお客様にお知らせいたします。この変更は、SDI モールド コンパウンドのいくつかについてサムソンから受けた生産終了の通知に起因します。SDI モールド コンパウンドの廃止によって、オン・セミコンダクターでは既存の材料の供給が限定されるようになるため、このことによって通常の変更通知期間が確保できない場合があります。対象となる製品の他の特徴(形状、適合性、機能)には変更はありません。		
	変更前の表記	変更後の表記
モールド・コンパウンド	SL-7300HFM; Supplier: Samsung SDI	KTMC1050GFA, Supplier : KCC



信頼性データの要約:

デバイス名: FJL6920TU (PTI : FD)RMS : U56663パッケージ : TO-264

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +110°C, RH=85% , 264hr, bias = 80% of rated V or 100V max	264hr	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

デバイス名: FGL40N120ANDTU (PTI : FC)RMS : U56660パッケージ : TO-264

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	TA = 150 °C for 1008 hours, 100% rated Vgs	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +130°C, RH=85%, 96hr, bias = 80% of rated V or 100V max	96hr	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

デバイス名: SGL160N60UFDU (PTI : FC)RMS : U56661/U59581パッケージ : TO-264

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	TA = 150°C for 1008 hours, 80% of max rated	1008 hrs	0/77
HTGB	JESD22-A108	TA = 150 °C for 1008 hours, 100% rated Vgs	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	TA = 150°C for 1008 hours	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C for 1000 cycles	1000 cyc	0/77
HAST	JESD22 A110	Temp= +130°C, RH=85%, 96hr, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hrs	0/77
RSH	JESD22 B106	265 C Immersion, 10 sec dwell	10s	0/10
SD	J STD 002	Ta=245°C 5 sec dwell	5s	0/15
Tri-temp		Tri-Temp Characterization, Per 48A		0/30
TR		Thermal Resistance		0/10
PD		Thermal Resistance Per Case Outline		0/10

すべての信頼性結果が合格.



電気的特性の要約: 電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
2SA1943RTU	FJL6920TU
FJL4315OTU	
FGL12040WD	FGL40N120ANDTU
FGL35N120FTDTU	
FGL40N120ANTU	
FGL60N100BNTD	
FGL40N120ANDTU	
FGL60N100BNTDTU	
SGL160N60UFDTU	SGL160N60UFDTU
SGL50N60RUFDTU	
FDL100N50F	
FQL40N50	
FQL40N50F	